
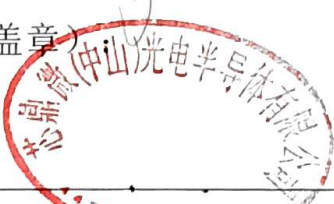



## 水土保持行政许可承诺书

编号: 2023010

项目名称	芯鼎微(中山)光电半导体有限公司年产硅基芯片 300 万片一期第一批次新建项目
建设地点	项目位于中山市民众街道沿江行政村, 项目场地中心地理坐标为东经 113°29'58.87", 北纬 22°35'7.21"。
水土保持方案公开情况	公示网站: <a href="http://www.zscjhb.com/new_info.html?article_id=10467">http://www.zscjhb.com/new_info.html?article_id=10467</a>
	起止时间: 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1 月 6 日
	公众意见接收和处理情况: 我单位已于 2022 年 12 月 22 日将《芯鼎微(中山)光电半导体有限公司年产硅基芯片 300 万片一期第一批次新建项目水土保持方案报告书》予以公开, 公示持续时间已超过 10 日, 公示期间未收到公众提出的问题和意见。
生产建设单位	名称: 芯鼎微(中山)光电半导体有限公司
	统一社会信用代码: 91442000MA55R3A18G
	地址: 中山市民众街道沿江行政村
	电子邮箱: @139.com
	法定代表人: 岑元骥
	授权经办人姓名: 陈敏政

<p>生产单位承诺内容</p>	<p>1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3.严格执行水土保持三同时制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。</p> <p>4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。</p> <p>5.积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。</p> <p>7.方案明确弃土去向，报告已附弃土点允许接收弃土和落实了水土保持责任的证明材料。</p> <p>8.其他需承诺的事项：          法人代表（签字）：          生产建设单位（盖章）：</p> <p style="text-align: right;">2023年1月13日</p>
<p>审批部门许可决定</p>	<p>上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。</p> <p style="text-align: right;">          水行政主管部门或者行政审批部门（盖章）          2023年1月17日</p>

备注： 1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。

3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门、监督检查部门各执1份。